

ファインポリマーズ株式会社

1. 会社状況

(本社)所在地	〒270-0216 千葉県野田市西高野353		代表者名	武田幸一		
電話/FAX番号	04-7196-1141/04-7196-1144	URL	www.fine-polymers.co.jp/			
設立年月	1973年7月(昭和48年7月)	資本金(百万円)	240			
売上高(百万円)	1,200(2014年度)	従業員(名)	36			
事業内容	エポキシ樹脂の製造/販売 半導体薬品の製造/販売					
主要製品	EpiFine…電気部品の接着剤・LED封止樹脂他 Ecopleer…半導体ウエハーの洗浄薬液					
東葛テクノプラザ 連絡先	役職名	業務部長	氏名	光山洋文	電話番号	090-2339-1144
	E-mail	hi-kouyama@fine-polymers.co.jp	入居室	401, 409		

2. 東葛テクノプラザにおける研究・事業開発概要

大手電機メーカー及び大手化学品製造メーカーと共同し、LED用封止樹脂の生産技術を確立する研究。

【特徴】

現有のLED製造プロセスは、液状封止樹脂にてダイオードを封止するプロセスが主になっています。近年、照明分野に白色LEDが使用されるようになり青色LEDを蛍光体を分散した液状封止樹脂で封止することで製造されています。

欠点として、液状封止樹脂では硬化工程で蛍光体が比重の関係で沈降が発生し均一性が保てません。当社が開発中の封止樹脂は、沈降の発生しない固形状の樹脂に蛍光体を均一に分散できる技術です。

今回開発中の封止樹脂は、液状封止樹脂による製品製造に比較し大幅に時短が計れる特徴も有します。

3. コア技術(保有技術等)

事業として、Epoxy配合品・半導体用薬液・新技術の3部門で構成されております。

○Epoxy配合品

接着剤…常温管理可能な1液性接着剤
(被着体の隙間を接着する際に、流動性を調整できる技術)
LED用…素材メーカーと協働して素材開発

○半導体用薬液

有機溶剤等の危険物・毒劇物を使用しないで、最先端デバイスである微細なCu配線基板に対応した水系洗浄液を開発。

○新技術

東北大学と共同開発で、ナノ粒子分散薬液開発。
大手、素材メーカー及び電気メーカーと共同開発で、LED用の新マテリアル製造技術開発。

4. 事業展開

現事業に関しては、台湾子会社及び親会社の海外現法と協働して2nd工場を展開。
日本顧客の海外進出対応に対応。

○Epoxy配合品

接着剤…需要が伸長している関係で工場増設
LED用…台湾子会社の有効活用

○半導体用薬液

次世代半導体用の薬液開発中。
増産に関しては、OEM等の検討。

○新技術

東葛テクノのLabを利用し、既存商品に対してコンタミとなり既存工場内で取り扱えない新規原材料での開発。
(シリコン・HB・アクリル・特殊フィラー等)

特記事項

【認定・受賞】